

圣戈鲁 **SGLTEK** 8827X 双组份导电银胶

不含溶剂，80~120°C固化，多种材料的高强度导电粘结



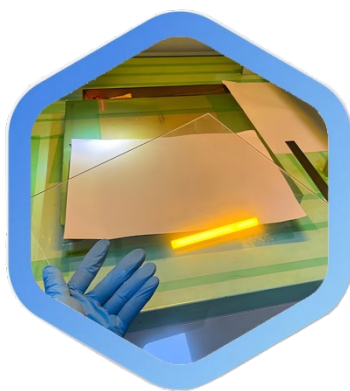
双组份易运输，加温快速固化，高强度，低电阻
为难以焊接的材料提供高强度的导电粘结

加温固化型

1. 环氧导电银胶，**粘结强度高**
2. 可密封性粘结，**不含挥发性溶剂**
3. 可较低温度固化，**80~150°C固化**
4. 可粘结**金属、石墨、陶瓷、玻璃**
5. 耐温较高，**-50~280°C工作**
6. 操作时间较长，**48小时@25°C**

圣戈鲁**SGLTEK** 8827X产品应用场景

双组份导电银胶：基于环氧树脂为粘结基材的银胶，较低的固化温度兼顾了良好的导电性能以及多种材料的高强度粘结, 并且可以在-50~280℃工作。



金属材料

产品的元器件在高温下提供稳定的导电粘结，电阻小，粘结力好。双组份易储存，现配现用，操作时间长。

- ✓温控阀芯
- ✓医疗靶材
- ✓芯片焊接

非金属材料

环氧树脂为基体材料，可以粘结石墨，导电玻璃，陶瓷等材料，解决了不能焊接的问题。

- ✓石墨双极板
- ✓陶瓷、玻璃
- ✓声波换能器



Two-Component Silver Conductive Adhesive

圣戈鲁SGLTEK 8827X双组份导电银胶

Technical Data Sheet

产品概述： 该产品属于双组份环氧导电银胶，加温固化；耐温280℃，低电阻高强度。能够代替锡焊，对金属，陶瓷，石墨, 导电玻璃等材料进行高强度导电粘结



产品指标：

项目	单位	A（甲组份）	B（乙组份）
外观	-	银色膏状	银色膏状
粘度	mpa·s（25℃）	10000~12000	10000~12000
密度	g/cm ³	1.98~2.01	2.98~3.01
混合后粘度	mpa·s（25℃）	10000~12000	
混合比例	-	A:B=1:1（重量比，不是体积比）	
可操作时间	hr（25℃）	48小时	
固化时间	hr（150℃）	150℃*1小时固化	
可选择固化温度	-	150℃ 6分钟 或 120℃ 20分钟 或 80℃ 3小时	
项目	单位	指标	测试方法
导热系数	W/m·k	3	GB/T 3399
体积电阻率	Ω·cm	<5x10 ⁻⁴	四探针
工作温度	℃	-55~+280	进行了3次循环，胶块不应开裂，性能仍符合要求
包装	10g/套 针管装；100g/套 瓶装，200g/套 瓶装		
产品保质期	25℃保存12个月；建议冷藏防止分层		